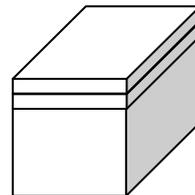
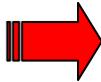
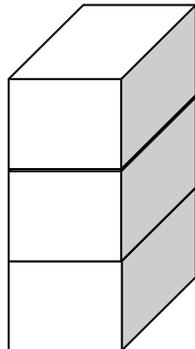
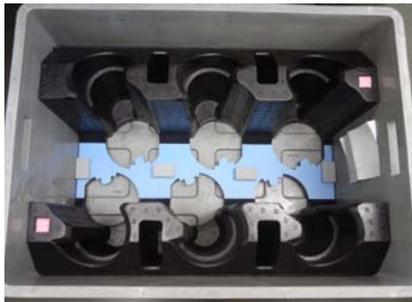


荷姿改善

■EPP発泡成形中敷を真空成形中敷に変更



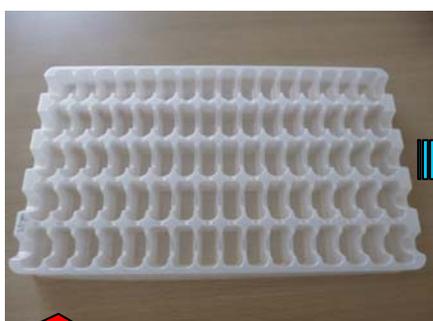
▲積み重ねると
保管時のスペースがかさばる

▲初期投資に凹凸の
金型が必要になる

👍 積み重ねがきくので
保管時の小スペース化に成功

👍 1枚当たりの
コストも約25%ダウン!

■エスポーレン組仕切を真空成形中敷に変更



▲輸送の振動や
段積みの衝撃で、仕切が浮き
製品が仕切の下に潜り込む不具合発生

👍 成形中敷を作成し
製品潜り込みの不具合は無くなった

👍 初回に金型費は必要になりますが、
250枚以上作るとその費用も吸収できます
初回以降は、コストも約80%もダウン!

■平置き製品を仕切枠荷姿に変更



▲平置きしかできていなかった
プレーカーの基盤回路

👍 箱の中に仕切を設けることにより
同一面積当たりの収容数をUP!

👍 仕切のサイズや仕切の方向を変更すれば
様々な基盤の種類の変更に可能